



各 位

2019年7月26日

会 社 名 日本電子材料株式会社
代 表 者 代表取締役社長 大久保 和正
(コード番号 6855 東証第一部)
問 合 せ 先 専務取締役 管理部門統括部長 足立 安孝
電 話 06(6482)2007

包括クロスライセンス契約の解約のお知らせ

当社は、株式会社日本マイクロニクス（本社：東京都武蔵野市、東証第一部・コード番号6871）との間で、2010年7月23日以降、プローブカードおよびプローブに関する「包括クロスライセンス契約」（以下、「本契約」といいます。）を締結しておりましたが、本日付にて本契約を解約致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 本契約の内容

対象製品：プローブカードおよびプローブ

契約内容：特許権の相互の実施許諾

なお、本契約に基づき、本契約の解約日までに実施許諾の対象であった特許権、および本契約の解約日から1年以内の両社何れかの出願に基づく特許権につきましては、本契約の解約後も引き続き相互に実施許諾の対象となります。

2. 本契約の解約理由

本契約について、両社で協議の結果、目的の一定程度を達成したと判断し、解約に至りました。

3. 業績に与える影響

本件が当社業績に及ぼす影響は軽微です。

4. 参考資料

	株式会社日本マイクロニクス	日本電子材料株式会社
本社所在地	東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号	兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号
設立	1970年	1960年
代表者	代表取締役社長 長谷川 正義	代表取締役社長 大久保 和正
資本金	50億1,835万円	9億8,310万円
連結売上高	300億円（2018年9月期）	144億円（2019年3月期）
事業内容	半導体計測器具、半導体・FPD検査機器等の開発、製造、販売	半導体検査用部品等の開発、製造、販売
HPアドレス	http://www.mjc.co.jp/	http://www.jem-net.co.jp/

以 上